

“机遇 挑战 合作 共赢”

中芯国际举办首届“设计服务生态系统日”



中芯国际设计服务中心于2017年7月28日下午在上海成功举办第一届芯片设计生态系统日，主题为“机遇 挑战 合作 共赢”。来自中、美、英、法、台湾、香港等国家和地区的，约50家芯片设计供应商的60位的首席执行官、副总裁，总监和大学教授参与了本次活动。6个现场演示展示了IP供应商和中芯国际最新的合作成果。

本次大会采用主题演讲结合嘉宾论坛的形式，围绕新时代下的机遇，挑战，合作，共赢的思想，呈现了多场精彩演讲。



中芯国际首席执行官赵海军博士通过视频与参会嘉宾交流

中芯国际首席执行官赵海军博士通过视频发表演讲，分享了中芯国际未来的发展方向和策略，高度认可了由 IP 供应商，EDA 供应商，IC 设计服务供应商和院校等组织构建的芯片设计生态系统的价值，并激励供应商们一起和中芯国际更快更好的为双方共同的客户服务，创建更大的共赢局面。

中芯国际执行副总裁汤天申博士分享了中芯国际设计服务中心的定位，并就智能化时代芯片设计所面临的挑战，剖析了现有的方法，并创新地提出了三维服务空间理念，以应对挑战。同时汤天申博士还重点介绍了中芯国际设计服务中心构建芯片设计生态系统的策略，方法和要求。



中芯国际执行副总裁汤天申博士发表主题演讲

除此之外，还有来自客户专家和大学教授，就前沿科技做了精彩演讲；6 位来自业界领军的 IP 公司，EDA 公司，和设计服务公司的高管，以及 1 位大学教授一起进行了精彩纷呈的圆桌讨论。

中芯国际执行副总裁汤天申博士表示：“我们诚挚感谢芯片设计生态合作伙伴的支持，并希望通过此次大会，增进我们同供应商之间的了解，使今后的合作更加高效。未来中芯国际将继续和芯片设计生态合作伙伴一起，完善质量，强化技术创新，提高效率，不断为客户提供更加优质的服务，与客户一起协作共赢。”



参会嘉宾进行圆桌论坛